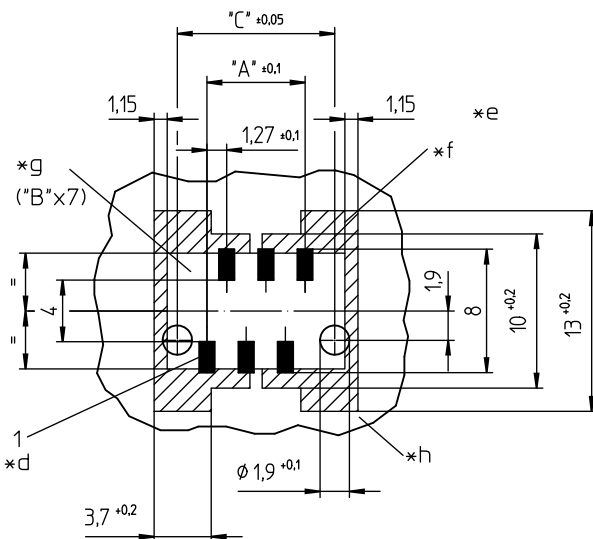
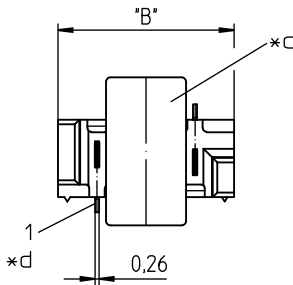
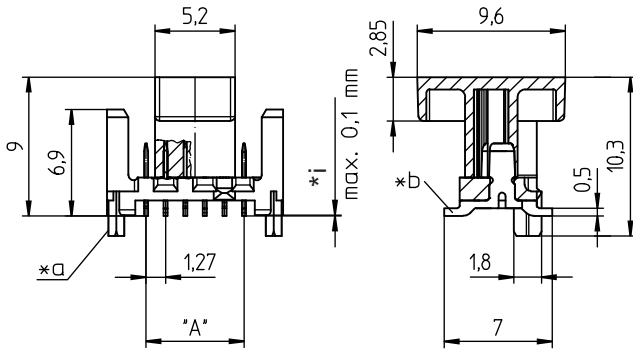


SMT



MICS/SMD RP

Micromodul™-Messerleiste, stehend, in Surface-Mount-Technik (SMT), Lötkontakte doppelreihig versetzt, mit Einpresszapfen und Bestückungskappe

- 1. Temperaturbereich** -40 °C/+140 °C¹
- 2. Werkstoffe**
 Kontaktträger PA GF, V0 nach UL 94
 Kontaktmesser MICS... CuZn, unternickelt und verzinkt
 Kontaktmesser MICS... AU CuZn, unternickelt und vergoldet
 Bestückungskappe PA GF, HB nach UL 94
- 3. Mechanische Daten**
 Ausdrückkraft Kontaktmesser aus Kontaktträger ≥ 7 N/Kontakt
 Kontaktierung mit Steckverbinder MICA
- 4. Elektrische Daten**
 Bemessungsstrom 1,2 A
 Bemessungsspannung² 80 V AC (250 V AC)
 Isolierstoffgruppe² II (IEC)/1 (UL) (CTI ≥ 450)
 Kriechstrecke 0,97 mm
 Luftstrecke 0,97 mm
 Isolationswiderstand > 1 GΩ

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektr.) der UL Yellow Card nach DIN EN 60664/IEC 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A
² Spannungsangabe 250 V ohne Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664/IEC 60664



- *a Einpresszapfen
press-fit spigot
goujon à enfoncer
- *b SMT-Lötbereich, Kontaktauflage 0,3 x 1,2 mm
SMT solder area, contact bearing surface 0.3 x 1.2 mm
partie des soudage SMT, surface d'appui de contact 0,3 x 1,2 mm
- *c Bestückungskappe
pick-and-place top
chapeau pour pose automatique
- *d Kontakt 1
contact 1
- *e Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper
- *f nötiger Freiraum für Verwendung der Abziehzange AZ30
necessary space for use of pull-off tongs AZ30
espace nécessaire pour utilisation de la pince de séparation AZ30
- *g Bestückungsfläche (B x 7)
component area (B x 7)
espace à équiper (B x 7)
- *h empfohlene Leiterplattendicke 1,5 ±0,14 mm
recommended thickness of circuit board 1.5 ±0.14 mm
épaisseur recommandée de la carte imprimée 1,5 ±0,14 mm
- *i Koplanarität
coplanarity
coplanarité



Micromodul™-Steckverbinder, Raster 1,27 mm
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Connecteurs Micromodul™, pas 1,27 mm

MICS/SMD RP

Micromodul™ tab header, upright, in surface mount technology (SMT), solder contacts dual row staggered, with press-fit spigots and pick-and-place top

1. Temperature range	-40 °C/+140 °C ¹
2. Materials	
Insulating body	PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab MICS...	CuZn, pre-nickel and tin-plated
Contact tab MICS... AU	CuZn, pre-nickel and gold-plated
Pick-and-place top	PA GF, HB according to UL 94
3. Mechanical data	
Expression force contact tab from insulating body	≥ 7 N/contact
Mating with	connectors MICA
4. Electrical data	
Rated current	1.2 A
Rated voltage ²	80 V AC (250 V AC)
Material group ²	II (IEC)/1 (UL) (CTI ≥ 450)
Creepage distance	0.97 mm
Clearance	0.97 mm
Insulation resistance	> 1 GΩ

¹ upper limit temperature (insulating body) RTI (electr.) acc. to UL Yellow Card according to DIN EN 60664/IEC 60664, CTI UL classification acc. to ANSI/UL 746A; voltage value 250 V without considering creepage distance and clearance according to DIN EN 60664/IEC 60664

²

MICS/SMD RP

Réglette à couteaux Micromodul™, droite, technologie des montages en surface (SMT), contacts à souder sur deux rangées espacées, avec goujons à enfoncer et chapeau pour pose automatique

1. Température d'utilisation	-40 °C/+140 °C ¹
2. Matériaux	
Corps isolant	PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à couteau MICS...	CuZn, sous-nickelé et étamé
Contact à couteau MICS... AU	CuZn, sous-nickelé et doré
Chapeau pour pose automatique	PA GF, HB suivant UL 94
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'expression contact à couteau du corp isolant	≥ 7 N/contact
Raccordement avec	connecteurs MICA
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	1,2 A
Tension assignée ²	80 V AC (250 V AC)
Groupe de matériau ²	II (CEI)/1 (UL) (CTI ≥ 450)
Distance d'isolement	0,97 mm
Ligne de fuite	0,97 mm
Résistance d'isolement	> 1 GΩ

¹ température limite supérieure (corps isolant) RTI (électr.) suivant UL Yellow Card

² suivant DIN EN 60664/CEI 60664, classification CTI UL suivant ANSI/UL 746A; valeur de tension 250 V en négligeant les distances d'isolement et les lignes de fuite suivant DIN EN 60664/CEI 60664

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Abmessungen Dimensions Dimensions		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
MICS/SMD 04 RP	4	3500	3,81	8,86	7,66
MICS/SMD 06 RP	6	3500	6,35	11,40	10,20
MICS/SMD 08 RP	8	3500	8,89	13,94	12,74
MICS/SMD 10 RP	10	3500	11,43	16,48	15,28
MICS/SMD 12 RP	12	3500	13,97	19,02	17,82
MICS/SMD 14 RP	14	3500	16,51	21,56	20,36
MICS/SMD 16 RP	16	3500	19,05	24,10	22,90
MICS/SMD 18 RP	18	3500	21,59	26,64	25,44
MICS/SMD 20 RP	20	3500	24,13	29,18	27,98
MICS/SMD 26 RP	26	2400	31,75	36,80	35,60

Verpackung: auf Rolle
 Packaging: on reel
 Emballage: en bobine